

平成22年度登録 全2件

設定登録番号	設定登録年月日	登録名義人		登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路の名称、分類 (構造・技術・機能)及び説明				
		名称	住所	名称	構造	技術	機能	説明
9154	平成23年2月7日	学校法人近畿大学	大阪府東大阪市小若江3丁目4番1号	IS-V16	MOS	その他	その他	(イ)素子の断面構造は以下の特徴を持つ。表面側からみて約10μmのn型エピ層と、20μm以上の厚さのp型エピ層の2重エピ層からなる裏面照射撮像素子。(以下略)
9155	平成23年2月16日	シャープ株式会社	大阪市阿倍野区長池町22番22号	LR359B1	MOS	CMOS	マイクロコンピュータ	CMOS1チップマイコン (ARMプロセッサコアとTeakDSPコアを搭載)